

## Boletín técnico informativo

Owensville, mayo de 2015

### Aislamiento preformado para placas de orificio de medición

#### Introducción

La preparación de las placas de orificio para el mantenimiento a menudo representa una tarea compleja y que lleva tiempo. El paquete de aislamiento debe prepararse y se debe tener mucho cuidado para garantizar que no queden vacíos debajo de la placa de orificio que puedan producir grietas. A fin de facilitar este proceso, Bucher Emhart Glass ahora ofrece aislamiento preformado para sus placas de orificio de medición.

El aislamiento preformado está fabricado con fibra cerámica biosoluble y moldeada para encajar de forma precisa dentro de la bandeja de acero con una cavidad lista para una placa de orificio. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario para preparar una placa de orificio para el mantenimiento.



Aislamiento preformado para placa de orificio para un DG de 10"/11"




Una unidad completa de placa de orificio con bandeja, aislamiento preformado y placa de orificio.

## Especificación

El aislamiento preformado para la placa de orificio está disponible en los siguientes tamaños:

Número de pieza	Serie de placa de orificio de medición
59-95511	Serie 81 SG 8"/9"
59-95512	Serie 81 DG 8"/9"
59-95513	Serie 81 TG 8"/9"
59-95514	Serie 503/515 SG 10"/11"
59-95515	Serie 503/515 DG 10"/11"
59-95516	Serie 503/515 TG 10"/11"
59-95517	Serie 585 DG 13" (diámetro del orificio de 1-3/8" a 2-1/2")
59-95518	Serie 585 DG 13" (diámetro del orificio de 2-9/16" a 3")
59-95519	Serie 585 DG/TG 13"

## Hoja de datos técnicos del material

<b>Nombre de la mezcla:</b>	<b>Aislamiento preformado para placa de orificio de fibra biosoluble</b>			
<b>Tipo:</b>	<b>Conformado al vacío</b>			
<b>Aplicación:</b>	Aislamiento de fibra cerámica de alta temperatura fabricado con fibras biosolubles. Baja conductividad térmica, estabilidad a alta temperatura y excelente resistencia al choque térmico con excelente resistencia a la flexión y a la compresión. Disponible en una amplia variedad de tamaños.			
<b>Características típicas</b>	<b>Densidad:</b>	<b>180 kg/m<sup>3</sup></b>	<b>Composición química:</b>	<b>Peso %</b>
 <b>REFRACTORY PRODUCTS</b>			<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>1 – 5</b>
	<b>Régimen de temperatura</b>	<b>1300 °C (2372 °F)</b>	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>70 – 80</b>
			<b>NaO</b>	<b>N/C</b>
	<b>Encogimiento lineal típico:</b>	<b>a 1250 °C – 2,6 %</b>	<b>CaO</b>	<b>N/C</b>
			<b>MgO</b>	<b>17 – 22</b>
	<b>Conductividad térmica:</b>	<b>800 °C – 0,23 W/mK</b>	<b>Otro</b>	<b>&lt;1</b>
		<b>1000 °C – 0,35 W/mK</b>		
	<b>1200 °C – 0,54 W/mK</b>			

Todos los datos están sujetos a variaciones razonables y no deben usarse para fines de especificación.

## Características / Beneficios

Preparación mínima necesaria para las placas de orificio.

⇒ Permite cambios de tarea más rápidos.

No es necesario “empaquetar” el aislamiento alrededor de la placa de orificio.

⇒ Se reduce el riesgo de vacío debajo de la placa de orificio.

El residuo del aislamiento se elimina fácilmente del fondo de la bandeja de acero.

⇒ Se reduce el tiempo necesario para limpiar las bandejas de acero para el próximo uso.

El aislamiento preformado se encuentra disponible en materiales biosolubles.

⇒ Los riesgos para la seguridad y salud de los operadores son menores en comparación con los materiales de fibra cerámica refractaria.